CB-D4

核心板

规格书

文档修改历史

版本	描述	日期
V4	创建	2020-03-17

目 录

第一章:	产品概述	2
第二章:	基本功能列表	5
第三章:	PCB 尺寸和接口布局	6
第四章:	电气性能	10
	命名规则	
第六章:	组装使用注意事项	12
第七章.	存储贴片注意事项	13



第一章:产品概述

1.1 概述

该核心板模块将 R311 除 WIFI 模块部分用到的管脚外几乎所有 IO 口全部引出,并且核心板采用单面贴方式,底板贴核心板的位置不需要开孔,为客户节省宝贵的 PCB 空间。大大降低了客户设计难度,并解决了客户设计周期长的难题,满足不同客户的需求,欢迎广大客户采购。

1.2 特点

- 集成度高:模块化设计,集成了PMIC、WIFI&BT4.0/4.2。
- 扩展接口丰富:引出了R311绝大部分的I0口
- 尺寸最小化: 模块的尺寸长宽高 67.5x47x2.8mm。

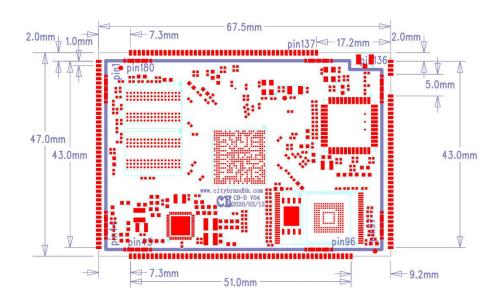


第二章:基本功能列表

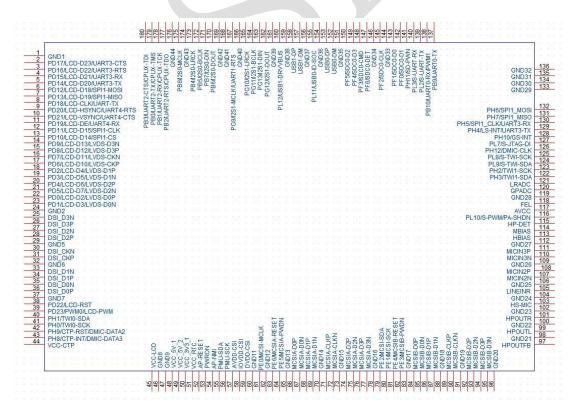
主要硬件指标					
СРИ	Allwinner R311 ARM-quad core cortex-A7 @1.8Ghz				
内存	DDR3 256MByte ~ 1GByte (By 16bit)				
内置存储器	SPI NOR, SPI NAND, SLC NAND, EMMC				
操作系统	Android8.1/TinaLinux				
USB2.0接口	1个 USB HOST/1个 USB OTG				
串口	4个串口				
GPI0	自定义				
WIFI/BT	内置 WIFI2. 4G/5. 8G & BT@4. 0/4. 2				
TF 卡输出	支持				
视频输入	支持 2 路 MIPI 摄像头输入				
音频输出	支持一路模拟音频(HPL&HPR)输出 2 路 I2S 输入输出				
LCD 输出	1路 MIPI (4 Line), 1路 RGB, 1路 LVDS (RGB 接口和 LVDS 接口部分管脚复用,所以 RGB 和 LVDS 不能同时用)				
MIC	2路 AMIC, 4路 DMIC				
POWER	DCIN 5V/2A				
按键	自定义				
系统升级	支持本地 TF 卡、USB、OTA 升级				

第三章: PCB 尺寸和接口布局

3.1 核心板 PCB 尺寸图



3.2 管脚定义



序号	定义	序 号	定义	序号	定义
1	GND	2	LCD-D23/PD17	3	LCD-D22/PD16
4	LCD-D21/PD15	5	LCD-D20/PD14	6	LCD-D18/PD12
7	LCD-D19/PD13	8	LCD-CLK/PD18	9	LCD-HSYNC/PD20
10	LCD-VSYNC/PD21	11	LCD-DE/PD19	12	LCD-D15/PD11
13	LCD-D14/PD10	14	LCD- D13/PD9/LVDS-D3N	15	LCD- D12/PD8/LVDS-N3P
16	LCD- D11/PD7/LVDS- CKN	17	LCD- D10/PD6/LVDS-CKP	18	LCD-D4/PD2/LVDS- D1P
19	LCD- D5/PD3/LVDS-D1N	20	LCD-D6/PD4/LVDS- D2P	21	LCD-D7/PD5/LVDS- D2N
22	LCD- D2/PD0/LVDS-D0P	23	LCD-D3/PD1/LVDS- D0N	24	GND
25	DSI_D3N	26	DSI_D3P	27	DSI_D2N
29	DSI_D2P	29	GND	30	DSI_CKN
31	DSI_CKP	32	GND	33	DSI_D1N
34	DSI_D1P	35	DSI_DON	36	DSI_DOP
37	GND	38	LCD-RST/PD22	39	LCD- PWM/PD23/PWMO
40	CTP-SDA/PH1	41	CTP-SCK/PH0	42	CTP- RST/PH9/DMIC- DATA2
43	CTP- INT/PH8/DMIC- DATA3	44	VCC-CTP(输出)	45	VCC-LCD(输出)
46	GND	47	GND	48	VCC_5V(输入)
49	VCC_5V(输入)	50	VCC_3V3(输出)	51	VCC_RTC(输出)
52	RESET	53	PWRON (AXP15060/P WRON)	54	AP- NMI (AXP15060/NMI)
55	PMU-SDA/PL1	56	PMU-SCK/PLO	57	AVDD-CSI
58	IOVDD-CSI(输出)	59	DVDD-CSI(输出)	60	GND

61	MCSI-MCLK/PEO	62	GND	63	MCSIA-RESET/PE6
64	MCSIA-PWDN/PE5	65	GND	66	MCSIA-DOP
67	MCSIA-DON	68	MCSIA-D1P	69	MCSIA-D1N
70	GND	71	MCSIA-CLKP	72	MCSIA-CLKN
73	GND	74	MCSIA-D2P	75	MCSIA-D2N
76	MCSIA-D3P	77	MCSIA-D3N	78	GND
79	MCSI-SDA/PE2	80	MCSI-SCK/PE1	81	MCSIB-RESET/PE4
82	MCSIB-PWDN/PE3	83	GND	84	MCSIB-DOP
85	MCSIB-DON	86	MCSIB-D1P	87	MCSIB-D1N
88	GND	89	MCSIB-CLKP	90	MCSIB-CLKN
91	GND	92	MCSIB-D2P	93	MCSIB-D2N
94	MCSIB-D3P	95	MCSIB-D3N	96	GND
97	HPOUTFB	98	GND	99	HPOUTL
100	GND	101	HPOUTR	102	GND
103	HS-MIC	104	GND	105	LINEINR
106	GND	107	MICIN2N	108	MICIN2P
109	GND	110	MICIN3N	111	MICIN3P
112	GND	113	HBIAS	114	MBIAS
115	HP-DET	116	PA-SHDN/PL10	117	AVCC (POWER)
118	FEL	119	GND	120	GPADC
121	LRADC	122	TWI1-SDA/PH3	123	TWI1-SCK/PH2
124	S-TWI-SDA/PL9	125	S-TWI-SCK/PL8	126	PH12/DMIC-CLK
127	PL7	128	GS- INT/PH10/DMIC- DATA1	129	LS-INT/PH4

			I		1
130	SPI1_CLK/PH5	131	SPI1_MISO/PH7	132	SPI1_MOSI/PH6
133	GND	134	GND	135	GND
136	GND	137	CPUX-TX/PB9	138	CPUX-RX/PB10
139	CPUS-TX/PL2	140	CPUS-RX/PL3	141	SD- PWN/PH11/DMIC- DATAO
142	SDCO-D1/PFO	143	SDCO-DO/PF1	144	GND
145	SDCO-CLK/PF2	146	GND	147	SDCO-DET/PF6
148	SDCO-CMD/PF3	149	SDC0-D3/PF4	150	SDC0-D2/PF5
151	GND	152	USBO-DM	153	USB0-DP
154	GND	155	USB0-ID-SOC/PL11	156	GND
157	USB1-DM	158	USB1-DP	159	GND
160	USB1- DRVVBUS/PL12	161	GND	162	I2S1-DOUT/PG12 (核心板 RF 模块 占用此管脚)
163	I2S1-DIN/PG13 (核心板 RF 模块 占用此管脚)	164	I2S1-BCLK/PG11 (核心板 RF 模块 占用此管脚)	165	I2S1-LRCK/PG10 (核心板 RF 模块 占用此管脚)
166	GND	167	I2S1-MCLK/PG9 (核心板 RF 模块 占用此管脚)	168	GND
169	GND	170	I2SO-DOUT/PB6	171	I2SO-DIN/PB7
172	I2SO-BCLK/PB5	173	I2SO-LRCK/PB4	174	GND
175	I2SO-MCLK/PB8	176	GND	177	CPUX-TDO/PB2
178	CPUX-TCK/PB1	179	CPUX-TMS/PBO	180	CPUX-TDI/PB3

PCB 板层: 6层板,单面贴。

PCB 板厚: 1.2mm

核心板尺寸: 67.5mm x47mm x 2.8mm

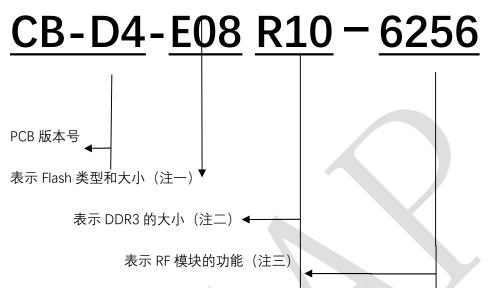
安装方式: 邮票孔安装

第四章: 电气性能

项目	类型	最小	典型	最大
电源电压	电压	4. 5	5V	5. 5
环境	相对湿度			80%
	工作温度	-20°C		70℃



第五章: 命名规则



注一: E表示 EMMC, N表示 SLC NAND, S表示 SPI NAND, 数字表示大小;

如 E08 表示 EMMC 8GByte, N08 表示 SLC NAND 8Gbit;

注二: R表 DDR3, 数字表示大小;

如 R09 表示 512MByte 的 DDR3; R10 表示 1GByte 的 DDR3;

注三: 6255 表示 RF 模块的型号, 6255 表示 AP6255, 8189 表示 RL 8189ETV, 6181 表示

AP6181

第六章: 组装使用注意事项

在组装使用过程中,请注意下面问题点:

- 一. 裸板与外设短路问题
- 二. 在安装固定过程中,避免裸板因固定原因造成变形问题
- 三. 注意 USB 接口的顺序
- 四. 注意邮票孔对接的正确性
- 五. 串口连接时,注意 TX 和 RX 接法是否正确
- 六. 注意输入电压电流是否正确



第七章:存储贴片注意事项

7.1 存储

7.1.1 保存期限

存储条件: 真空包装或防潮箱,温度 23±5℃、相对湿度 10~20%RH

存储期限: 在推荐存储条件下, 保存期为6 个月。

7.1.2 车间寿命

3 级潮湿敏感性产品的车间寿命为 24 小时。在车间温度 23±5℃,相对湿度低于 60%的环境下,要在 24 小时内对产品进行回流生产或其它高温操作,或存储在相对湿度小于 10%的环境中,以保持产品的干燥性。

7.1.3 烘烤

温度: 8 0 ±5℃

持续烘烤时间: 8小时

烤炉:对流换热炉

注意: CB-D 模块外包装不能烘烤。

7.1.4恒温及回流焊接

加热/回流阶段会产生超过 216-221℃的液相温度,需防止温度突然升高, 否则会增加焊膏塌陷的风险。 220℃以上液相温度时间: 30-70 秒。

峰值回流温度: 235~245℃。 预热时间(110~190℃): 60~120 秒。 升温斜率: 小于 3℃/s。

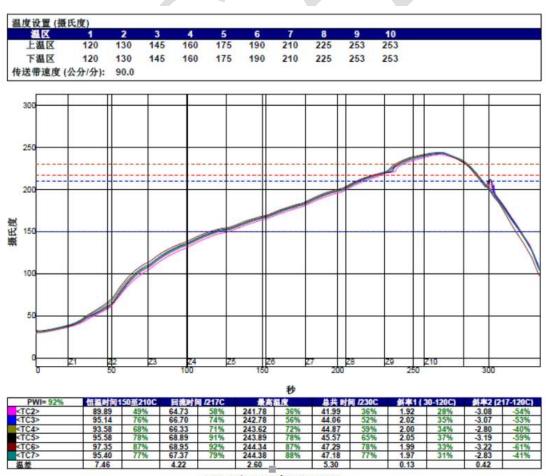


图1-9推荐参考炉温曲线

7.2 包装

CB-D3 模块采用防静电气泡袋包装方式,结合硬质卡通箱的外包装模式,对模块的存储、运输及使用起到最大限度的保护作用。 注意:

包装箱内附干燥剂。模块为潮湿敏感性器件,湿敏等级 3 级,符合美国电子元件工业联合会(JEDEC)规定。请避免由于产品受潮而造成永久损坏。 模块为精密电子产品,如果未采取正确的静电防护措施,可能会对模块造成永久的损坏。

Note:知识产权和解释权属城茗国际有限公司。

